证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2019-024

三安光电股份有限公司关于继续回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年5月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对三安光电股份有限公司2018 年年度报告的事后审核问询函》(上公函【2019】0657号),具体内容详见公司公告。公司已于2019年5月21日就《问询函》所涉及部分问题予以了回复公告。公司根据要求,进一步补充了剩余问题的材料,公司已逐项回复,且中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就《问询函》所涉及的相关问题进行了核查并出具《关于对三安光电股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函的答复》(众环专字(2019)011379)。现将相关事项公告如下:

3.公司应收账款及应收票据金额逐年大幅攀升。报告期内,公司应收账款及应收票据余额50.99 亿元,占营业收入比重为60%,其中应收票据26.17亿元,较期初增加76.59%。应收票据中商业承兑票据期末余额17.62 亿元,期初仅为2.06 亿元,同比增加755%。请公司进一步补充披露以下信息:

(1)结合行业地位、上下游议价能力、市场占有率等变化情况分析应收账款及应收票据占收入比例不断攀升的商业逻辑及合理性;

(2)按商业承兑汇票、银行承兑汇票分类披露应收票据的主要客户名称、对应销售产品名称、数量及金额,历史结算方式,是否与上市公司存在关联关系等,结合销售模式的变化情况说明本期大幅增加票据结算的原因及考虑;(3)公司报告期末商业承兑汇票是否类同应收账款计提坏账准备,若未计提,请说明原因和合理性,会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。请会计师对上述问题逐项核查并发表意见,说明履行的审计程序是否审慎、充分。

回复:

(一)结合行业地位、上下游议价能力、市场占有率等变化情况分析应收账款及应收票据占收入比例不断攀升的商业逻辑及合理性:

2017年末,2018年末公司应收票据及应收账款的情况如下所示:

项目	2018年12月31日金额(单位:元)	2018年12月31日金额占收入比例	2017年12月31日金额(单位:元)	2017年12月31日金额占收入比例
应收票据	2,617,255,888.11	31.29%	1,482,121,837.39	17.66%
银行承兑票据	854,311,444.61	10.21%	1,275,675,238.76	15.20%
商业承兑票据	1,762,944,443.50	21.08%	206,446,598.63	2.46%
应收账款	2,482,086,093.56	29.67%	2,389,972,640.36	28.47%
合计	5,099,341,981.67	60.97%	3,872,094,477.75	46.13%

公司2018年末应收票据及应收账款占收入比例为60.97%,较2017年末增加约15个百分点,其主要原因是公司应收商业承兑票据金额增加较多,而应收账款相对少量增加。其中,公司2018年末银行承兑汇票金额较年初减少42,136.38万元,2018年末商业承兑汇票较年初增加1155,649.78万元,2018年末应收账款较年初增加89,211.35万元。

公司2018年末应收票据中含公司收到厦门信达股份有限公司(以下简称“厦门信达”)8亿元商业承兑汇票,系公司购买设备款因合同取消退款金额。若扣除上述8亿元商业承兑汇票,则2018年末应收票据及应收账款占收入比下降至51.40%,较2017仅增加5.27个百分点。

2018年行业竞争加剧,企业资金链普遍紧张的影响,行业内使用现金付款比重下降,应收票据及应收账款结算比重上升。近2年同行业可比上市公司也存在较高的应收票据及应收账款占收入比例,且该比例高于公司。

	三安光电		聚灿光电		乾照光电		华灿光电	
	2018年末	2017年末	2018年末	2017年末	2018年末	2017年末	2018年末	2017年末
应收票据及应收账款占收比	61%	46%	65%	55%	107%	82%	65%	67%

数据来源:各上市公司年报

公司作为国内LED芯片行业龙头公司,近年来相关产品在国内市场占有率一直较高,在LED产品产业链中具有较强的上下游议价能力,面对2018年LED芯片市场竞争加剧,产品价格下降的压力,行业内使用现金付款比重下降,票据结算比重上升。公司为持续扩大市场份额,严格按照资信标准接受安全可靠的商业承兑汇票作为货款结算工具。同时,行业内下游厂商以商业承兑汇票向其供应商进行支付,供应商又将收到的商业承兑汇票进一步向其供应链上游背书转让以支付货款,或者客户直接向公司开具商业承兑汇票,商业承兑汇票的流转促进了产品在供应链上下游流通。因而,公司应收票据及应收账款占收入的比例增加。

综上所述,公司认为在当前经济环境下,应收票据及应收账款占收入比例增加有商业逻辑及合理性。

(二)按商业承兑汇票、银行承兑汇票分类披露应收票据的主要客户名称、对应销售产品名称、数量及金额,历史结算方式,是否与上市公司存在关联关系等,结合销售模式的变化情况说明本期大幅增加票据结算的原因及考虑;

1、公司2018年末银行承兑汇票相对应的主要客户及其他相关信息如下所示:

单位:元

序号	客户名称	银行承兑汇票金额	占2018年末银行承兑汇票金额比例	2018年销售产品名称	计量单位	销售数量	销售金额(含税)	历史结算方式(2017年度)
1	深圳市聚飞光电股份有限公司	102,769,913.71	12.03%	LED芯片	K	15,321,019	562,435,585.54	现金+银行承兑汇票+商业承兑汇票
2	浙江远景汽配有限公司	86,607,000.00	10.14%	LED车灯	PCS	1,316,952	224,804,777.96	银行承兑汇票
3	佛山市国星光电股份有限公司	67,790,333.53	7.94%	LED芯片	K	38,364,835	224,899,738.92	银行承兑汇票
4	浙江明度电子有限公司	55,895,968.28	6.54%	LED芯片	K	16,143,725	246,828,188.54	银行承兑汇票+商业承兑汇票
5	浙江众泰汽车制造有限公司	54,900,642.60	6.43%	LED车灯、模具、车灯材料	PCS	532,116	138,404,815.95	银行承兑汇票
6	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	43,038,586.49	5.04%	LED芯片	K	10,771,384	338,947,734.27	现金+银行承兑汇票+商业承兑汇票
7	江西鸿利光电有限公司	29,369,684.24	3.44%	LED芯片	K	4,906,875	88,421,945.96	现金+银行承兑汇票
8	深圳市糖晶光电股份有限公司	23,040,717.63	2.70%	LED芯片	K	4,115,884	184,346,268.23	银行承兑汇票+商业承兑汇票
9	广东恒润光电有限公司	22,227,788.39	2.60%	LED芯片	K	2,785,504	57,677,948.55	银行承兑汇票
10	鸿利智汇集团股份有限公司	20,336,044.84	2.38%	LED芯片	K	8,817,025	148,016,604.96	现金+银行承兑汇票
	总计	505,976,679.71	59.23%					

2、公司2018年末商业承兑汇票相对应的主要客户及其他相关信息如下所示:

单位:元

序号	客户名称	商业承兑汇票金额	占2018年末商业承兑汇票金额比例	2018年销售产品名称	计量单位	销售数量	销售金额(含税)	历史结算方式(2017年度)
1	厦门市信达光电科技有限公司	260,000,000.00	14.75%	LED芯片	K	229,354,716	629,012,979.10	现金+银行承兑汇票
2	深圳市聚飞光电股份有限公司	156,674,269.41	8.89%	LED芯片	K	15,321,019	562,435,585.54	现金+银行承兑汇票+商业承兑汇票
3	福建天电光电有限公司	140,110,860.00	7.95%	LED芯片	K	16,065,523	692,842,248.18	现金+银行承兑汇票
4	盐城东山精密制造有限公司	126,074,652.44	7.15%	LED芯片	K	90,656,052	205,580,533.22	商业承兑汇票
5	荆州市弘晟光电科技有限公司	70,859,742.23	4.02%	LED芯片	K	78,473,924	130,709,359.84	现金+银行承兑汇票
6	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	66,894,657.83	3.79%	LED芯片	K	10,771,384	338,947,734.27	现金+银行承兑汇票+商业承兑汇票
7	浙江明度电子有限公司	31,506,311.64	1.79%	LED芯片	K	16,143,725	246,828,188.54	银行承兑汇票+商业承兑汇票
8	安徽艾瑞达科技股份有限公司	15,932,122.93	0.90%	LED芯片	K	866,988	59,663,729.92	现金+银行承兑汇票
9	深圳市玲涛光电科技有限公司	14,489,897.52	0.82%	LED芯片	K	1,679,745	80,661,732.78	银行承兑汇票+商业承兑汇票
10	南昌易美光电科技有限公司	13,198,856.15	0.75%	LED芯片	K	2,847,994	93,462,574.08	现金+银行承兑汇票+商业承兑汇票
	小计	895,741,370.15	50.81%					
11	厦门信达股份有限公司	800,000,000.00	45.38%	详见下文说明				
	总计	1,695,741,370.15	96.19%					

注:厦门市信达光电科技有限公司、盐城东山精密制造有限公司、南昌易美光电科技有限公司销售及历史结算方式数据包括其附属企业。

除荆州市弘晟光电科技有限公司系公司持有33.34%股权的参股公司外,上述其他客户过去至目前与公司均不存在关联关系。

3.公司2018年末票据结算增加的主要原因包括:

(1)公司的主要销售模式为直销,近3年未发生变化,受企业资金链普遍紧张的影响,行业内使用现金付款比重下降,票据结算比重上升,尤其是商业承兑汇票结算比重增加较多。同时,公司产品销售给下游封装及应用厂商,上述厂商一般将其出票的商业承兑汇票支付给供应商,而上述供应商进一步将其收到的商业承兑汇票背书转让给公司,或者客户直接向公司开具商业承兑汇票,作为购买LED产品的结算工具。在激烈的市场竞争和去杠杆政策影响下,公司为扩大市场份额,在经营风险可控的情况下,给予客户适当期限的账期,故接受客户提供票据作为支付货款的工具。但公司对上述票据进行信用风险分析,仅接受资信高、风险低的票据。受上述宏观经济、行业因素的综合影响,公司上述主要客户所对应的2018年末商业承兑汇票金额较年初金额增加约5亿元。

(2)2018年末应收票据余额包括公司收到厦门信达股份有限公司8亿元商业承兑汇票,系公司购买设备款因合同取消待退款金额,其中3.6亿元汇票已于2019年6月20日到期承兑完毕,4.6亿元汇票应于2019年6月27日到期承兑。

泉州三安半导体于2018年5月9日、2018年7月2日,与厦门信达股份有限公司分别签订2份《代理进口协议书》,约定由厦门信达代理泉州三安半导体进口LED设备、半导体设备及材料,采购金额分别约为1.25亿美元和3.27亿美元。泉州三安半导体于2018年5月16日、2018年7月3日、2018年7月4日、2018年9月27日合计支付了14.25亿元预付设备款。

公司决定部分设备暂缓采购的原因:1.泉州三安半导体LED产业化项目外围配套的11万伏电站及供水、排污系统因园区外围配套延缓而延期投入使用,所以建设进度延期。泉州半导体新投资产业园区南安分园区管理委员会就外围配套延缓出具了说明。II.年末,公司泉州三安项目决定重点保证集成电路业务,对LED业务部分非急用设备暂缓采购。III.国际贸易形势变化,部分设备重新选型、进一步提升自动化程度以及核心设备考虑国产替代,均需时间重新进行评估。

综上所述,公司决定部分设备暂缓采购,经与厦门信达协商一致,厦门信达同意:1.于 2018年12月31日前以8亿元商业承兑汇票退还,需按年化4.35%向公司支付补偿金,期限自公司收到承兑汇票之日至汇票到期日;II.于2019年1月10日前退还剩余6.25亿元现金。同时泉州三安半导体向厦门信达支付因合同取消相关的违约金142.5万元。

公司已于2019年1月7日收到6.25亿元现金退款,3.5亿元汇票已于2019年4月26日到期承兑完毕,4.5亿元汇票于2019年6月27日到期承兑。公司已于2019年3月收到使用票据相关的补偿金1,494.7万元。

(4)公司向厦门信达光电板块各子公司销售LED芯片,价格是公允的。

(4.1)公司向厦门信达控制下的福建省信达光电科技有限公司等5家光电公司销售LED芯片。

厦门信达光电板块各子公司情况如下:

单位:元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
厦门市信达光电科技有限公司	8.1亿	2,817,300,487.04	1,462,933,604.46	351,569,829.98	8,417,006.78	18,847,471.68
福建省信达光电科技有限公司	1.5亿	1,403,969,862.13	888,354,861.42	485,717,745.62	40,233,697.83	49,847,012.77
深圳市安普光光电科技有限公司	5000万	380,007,091.70	118,052,656.13	250,925,841.18	-20,462,690.51	-15,343,868.65
深圳市瀛天光电有限公司	3000万	674,803,025.83	-2,252,093.85	405,359,673.47	1,254,600.45	1,014,845.23
广东安普光光电科技有限公司	3000万	220,090,212.49	28,340,117.03	228,555,713.17	5,284,444.42	3,786,850.67

(数据来源目厦门信达股份有限公司2018年报)

概括而言,厦门信达的光电业务聚焦于LED 封装及应用产品的研发、生产和销售,已从福建延申到广东、深圳珠三角地区。现已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展的业务格局,显示屏封装产能及出货量位居行业前列。2018年,信达光电业务因开展LED封装及应用产品业务需要,向公司采购LED芯片6.29亿元(含税价)。

(4.2)售与信达光电板块各子公司的芯片销售价格与相同规格型号全部客户平均单价相比较,价格是公允的。综上所述,公司与厦门信达及其附属企业之间的业务及资金往来均具有真实业务背景,不存在相关款项流向公司关联方的情形。

3、其他主要交易对于方情况

安溪县土地收储中心预付款余额1.4609亿元系晶安光电有限公司蓝宝石衬底产业化项目预付的土地保证金,现该块土地尚未交付给晶安光电使用。

其他主要交易对于信息如下表:

(一)

名称	经营范围	地址	成立时间	法定代表人	大股东	注册资本
苏州冠博控制科技有限公司	研发计算机控制系统,设计、生产温制程设备、气瓶柜、阀门箱、液体输送柜,销售自产产品,监控系统软件安装,提供相关技术咨询和培训服务;上述产品同类产品的进口、佣金代理(拍卖除外),进出口业务及其他相关配套业务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	苏州高新区	2016/5/31	马蔚	朋亿股份有限公司	100万美金
上海微电子装备(集团)股份有限公司	半导体装备,泛半导体装备,高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	中国(上海)自由贸易试验区	2002/3/7	张素心	上海电气(集团)总公司	147023.7887万元人民币
大族激光科技产业集团股份公司	经营进出口业务;物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案;激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件(不含限制项目),机器人相关产品的研发,生产和销售;普通货运。	深圳市南山区	1999/03/04	高云峰	香港中央结算有限公司	106706.5245万元人民币
上海茂华电子工程技术有限公司	半导体制造行业用的除害桶的再生,管道系统及相关设施设计、安装、调试及技术服务及半导体制造行业用的设备维修,电子、医疗设备技术咨询,电子产品,机械设备、化工产品(危险品除外)、通讯器材、金属制品、塑料制品的批发,佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套服务。【不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	中国(上海)自由贸易试验区	1998/4/21	高新明	RUSSKY H.K.LIMITED	60万美元
厦门盛达宏机电设备工程有限公司	其他未列明电气机械及器材制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);电工机械专用设备制造;电子工业专用设备制造;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工,其他未列明建筑安装业;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金产品批发;通讯及广播电视设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;五金零售;陶瓷、石材装饰材料零售;通信设备零售;其他电子产品零售;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);专业化设计服务;工程管理服务;软件开发,信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);合同能源管理,工程和技术研究和试验发展。	厦门市湖里区	2014/7/22	樊珺	樊珺	3000万元人民币
厦门建益达有限公司	经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;电气设备批发;通讯及广播电视设备批发;通信设备零售;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;灯具、装饰物品批发;灯具零售;家用电器批发;日用家电设备零售;其他机械设备及电子产品批发;其他电子产品零售;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);电气设备修理;其他机械和设备修理业;仪器仪表修理;通用设备修理;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);通信系统设备制造;通信终端设备制造;光电子器件及其他电子器件制造;其他电子设备制造;电光源制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;其他未列明电气机械及器材制造;电子元件及组件制造;印刷电路板制造;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;第二、三类医疗器械批发;第二、三类医疗器械零售	厦门市思明区	1996/4/1	陈东旭	厦门建发股份有限公司	10000万元人民币
福建省晋江市开关厂	高低压开关柜控、照明箱制造、电力控制开关制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	晋江市陈埭镇	1983/4/20	陈志雄	陈诗霖	6700万元人民币

公司认为上述主要交易对于均为主营半导体相关设备生产、销售的公司,与公司均无关联关系,资金未流向公司关联方。

(二)对应的工程项目及相关投入情况,分析公司报告期内新增大额预付工程设备款的合理性。

2018年新增的大额预付工程设备款主要系厦门信达股份有限公司净增9.96亿元、上海微电子装备(集团)股份有限公司净增0.67亿元、苏州冠博控制科技有限公司净增0.54亿元、大族激光科技产业集团股份有限公司净增0.50亿元。预付款项主要系为泉州三安半导体科技有限公司LED产业化项目、厦门市三安集成有限公司集成电路项目采购设备预付的款项。

泉州三安半导体科技有限公司LED产业化项目总投资额设计为333亿,目前处于基础设施建设、设备选型及部分购入阶段。厦门市三安集成有限公司集成电路项目总投资额设计为30亿,目前处于边建设、边投产阶段。2018年芯片车间又新增了光通和SIC项目,GaN、外延、新增的SIC、光通极块相应新购入了机器设备。项目投入具体情况详见关注事项的详细说明。根据在建项目投入的具体进度,公司2018年新增大额预付工程设备款是合理的。

11.关于预付款项。年报披露,公司预付款项期末余额6.66亿元,较上期增加比例达到111.04%,公司解释系预付材料款增加所致。请公司补充披露:(1)报告期内新增预付款项的对象、金额和具体用途,并明确预付对象与公司的关联关系,相关资金是否最终流向关联方;(2)按预付款项的用途披露预付账款的构成情况,并分析说明预付账款大幅增加的原因及合理性。请会计师对上述问题核查并发表意见。

回复:

(一)报告期内新增预付款项的对象、金额和具体用途,并明确预付对象与公司的关联关系,相关资金是否最终流向关联方:

1,公司2017、2018、2019年4月预付款项明细表

单位:元

预付款项对象	具体用途	2017年余额	2018年余额	2019年4月30日	是否最终流向关联方
福建省安溪县对外贸易公司	晶棒、抛光液、钻石线、碳化硼等		316,578,237.77	23,905,873.47	否
贵研铂业股份有限公司	贵金属	59,453,905.75	130,700,569.23	1,578,522.09	否
中材科技股份有限公司	贵金属	51,090,226.28	50,743,404.24	30,810,859.87	否
紫金矿业集团黄金珠宝有限公司	贵金属	54,961,087.48	37,881,514.14	31,741,820.00	否
银关通电子口岸	通关费用	13,835,089.48	28,178,832.61	70,542,063.89	否
monocrystal plc	晶棒	10,010,110.09	24,199,580.41		否
苏州普耀光电材料有限公司	MO源	3,609,163.80	11,588,538.63	32,028,907.70	否
福建天电光电有限公司	封装产品		6,863,200.00		否
艾瑞上海贸易有限公司	备品备件	3,840,014.56	4,148,322.87	6,049,683.33	否
浙江众泰汽车制造有限公司	三包服务费		3,385,669.37		否
厦门吉瓦特照明科技有限公司	LED灯	3,313,292.53	3,141,531.75	2,491,531.75	否
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司	晶棒	49,024,012.62			否
浙江长川工程塑料有限公司	PC塑料粒子	6,859,058.04			否
芜湖金贝模塑科技有限公司	车灯备件	3,305,809.28			否
厦门宇臻集成电路科技有限公司	工艺技术开发验证费	3,060,000.00			否
厦门信达股份有限公司	备品备件及水化金	1,813,553.43	2,618,446.82	2,416,345.09	否
Norstel AB	外延片		2,513,675.55	1,668,472.47	否
厦门钨科电子科技有限公司	工艺技术开发验证费		1,800,000.00		否
厦门市萨珀莱照明技术有限公司	LED灯	2,894,012.47		118,355.98	否
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	金靶、贵金属	2,720,118.30	921,335.26	5,670,569.60	否
安徽亚格盛电子新材料有限公司	MO源	2,713,794.24			否
中科晶电信息材料(北京)股份有限公司	砷化镓衬底	2,307,778.19			否
其他小计		40,902,802.13	41,031,810.40	41,688,783.05	否
合计		315,713,828.67	666,294,669.05	250,711,788.29	
明细披露占比		87.04%	93.84%	83.37%	

公司列示了2018年预付款项93.84%的明细,2018年预付款项期末余额6.66亿元,较上期增加比例达到111.04%,主要系福建省安溪县对外贸易公司2018年增加了3.17亿元。公司与安溪县对外贸易公司交易过程真实,安溪县对外贸易公司也回函确认自己公司收到的业务款项均未流向公司关联方。综上所述,上述预付款项对象均与公司不存在关联关系,相关资金没有最终流向关联方。

(二)按预付款项的用途披露预付账款的构成情况,并分析说明预付账款大幅增加的原因及合理性。请会计师对上述问题核查并发表意见。

1、公司预付账款主要系预付材料款和预付通关税费,本期用途构成没有变化。

2、2018年预付款项期末余额6.66亿元,较上期增加比例达到111.04%,主要系福建省安溪县对外贸易公司2018年末余额增加了3.17亿元。

福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底产业化项目落户泉州安溪,现正生产和第三期建设同时进行;晶安光电生产后的衬底及其他材料为整个三安光电LED业务各子公司使用。泉州三安半导体科技有限公司LED产业化项目办落户泉州南安。为了满足公司现有业务和新建生产基地的需求,公司2018年委托安溪县对外经贸公司采购抛光液,钻石线,碳化硼及4寸、6寸晶棒等材料,合同金额为6,011亿元,晶安光电预付3,6066亿元。2019年4月30日账面余额23,905,873.47元为在途材料暂估值,5月已收到该批材料。

公司预付款的增加系为了保障供应链的稳定,优化供应商结构,对核心原材料进行适度储备,以满足公司正常的经营需求,保证公司现有业务、泉州三安新建项目储备贵金属、晶棒、抛光液等原材料。公司认为预付账款增加的原因符合商业逻辑和公司项目的需要,具备合理性。

12.请公司核查目前库存资金状况、并全面梳理与控股股东及其关联方资金往来情况及担保情况。请说明公司近三年直接或间接流向控股股东及其关联方的资金金额、款项性质,说明是否存在资金被控股股东及其关联方占用,公司为控股股东及其关联方提供违规担保,以及上市公司利益被控股股东及关联方侵占的情形。请会计师对上述问题逐项核查并发表意见,说明履行的审计程序是否审慎、充分。

回复:

1,公司目前库存资金状况正常

如前述事项1核查结果,公司目前库存资金状况正常。(参见关注事项1的说明)

2,公司与控股股东及其关联方资金往来情况及担保情况的全面核查

(1)近三年担保情况已在年度报告中详细披露。近三年,公司除已披露的对外担保外,不存在其他对外担保,不存在违规对外担保情形。

(2)近三年公司与控股股东及其关联方资金往来情况已在年度报告中详细披露。

近三年,公司除已披露的关联方交易外,不存在上市公司资金被控股股东及其关联方非经营性占用以及上市公司利益被控股股东及关联方侵占的情形。

13.关于材料、废料销售业务。公司主营业务收入中,材料、废料销售实现收入14.19 亿元,毛利率高达81.68%,比上年增加6.15%,拉开了公司整体毛利率,但同行华灿光电等可比上市公司并未开展上述业务。请公司补充披露:(1)材料、废料销售情况与主营业务相关性与必要性;(2)与同行存在差异的原因,并结合其商业模式、销售政策、收入确认等情况,解释对应的会计处理及考虑;(3)与控股股东及其关联方的金属贸易业务是否存在资金、业务往来。请会计师进行核查并发表明确意见。

回复:

(一)材料、废料销售业务与主营业务相关性与必要性;

1,公司材料、废料业务收入构成

产品类别	具体品类	2018年销售收入(万元)	销售占比(%)
贵金属废料	黄金、铂金、其他贵金属废料	106,993.30	75.38%
其他材料	品类众多,如塑料粒子、塑料制品、模具及开发、RP件、备件、金靶等	34,953.35	24.62%
合计		141,946.65	100.00

公司材料、废料收入主要来自贵金属废料回收并对外销售产生的收入,占材料、废料销售收入的75.38%。

公司材料、废料业务中的其他材料合计占材料、废料销售收入的24.62%,包括的品类众多,如塑料粒子、塑料制品、模具及开发、RP件、备件、金靶等,任一种材料占比都比较低,均是与公司主营业务相关的材料产品。

2、贵金属在LED芯片和集成电路生产过程中的使用情况

贵金属包括黄金、铂及其他贵金属材料,其中黄金和铂占贵金属总采购量超过90%。贵金属因其良好的稳定性、导电性等物理特性,被广泛应用于半导体芯片制造的电极制作环节中。主要工艺过程是通过蒸镀、溅镀等方式将贵金属覆盖到外延片的电极上,从而实现电极导电性能。

目前行业工艺技术是通过蒸镀、溅镀等方式将贵金属覆盖到整个外延片的方式实现对电极表面的覆盖(电极面积通常仅占整个外延面积的2%-8%),因此除覆盖到外延片电极部分的贵金属外,其余覆盖的贵金属大都作为废料回收。

公司LED芯片业务和集成电路芯片业务生产工艺中均需要用到贵金属,主要工艺过程列示如下:

LED芯片工艺过程:

在LED芯片工艺流程中,贵金属一般被用于金属电极制作环节。

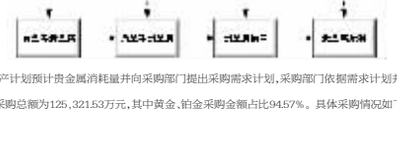
集成电路工艺过程:

在集成电路工艺流程中,贵金属一般被用于电极制作环节。

3、贵金属废料回收出售的商业逻辑

由于电极制造工艺过程对杂质含量控制要求比较高,电极制作所需贵金属材料一般要求纯度在99.999%以上,高纯度的贵金属材料经过高温熔合蒸镀之后,残留在产品、设备等多处地方,需作为贵金属废料回收。回收的贵金属废料与最开始采购的贵金属相比,在重量、体积、成份、纯度等方面均已发生很大变化,无法再重新用于芯片电极制作,需专业机构回收处理。

4、商业模式



(1)采购

公司生产部门依据生产计划预计贵金属消耗量并向采购部门提出采购需求计划,采购部门依据需求计划并结合贵金属市场价格下单采购。

2018年,公司贵金属采购总额为125,321.53万元,其中黄金、铂金采购金额占比94.57%。具体采购情况如下:

(下转B072版)